

浙江省半导体行业协会

浙半函发〔2026〕18号

关于对《车规级 AI 芯片电性参数测试方法》、《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范》团体标准征求意见的函

各有关单位及专家：

根据《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）、《浙江省半导体行业协会团体标准管理》有关规定，由我协会组织制定，杭州朗迅科技股份有限公司等作为主要起草单位的《车规级 AI 芯片电性参数测试方法》团体标准、由浙江机电职业技术大学等作为主要起草单位的《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范》团体标准已经完成征求意见稿，现公开征求意见，诚邀各相关单位及个人对其提出宝贵意见和建议，并于2026年9月23日前将修改意见和建议反馈到本协会。

回函单位：浙江省半导体行业协会

回函地址：杭州市滨江区月明路567号医惠中心B座606

联系人：赵燕明

联系电话：18324435116

邮箱：446259781@qq.com

附件：

- 《车规级 AI 芯片电性参数测试方法（征求意见稿）》团体标准
- 《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范（征求意见稿）》团体标准
- 《车规级 AI 芯片电性参数测试方法（征求意见稿）》团体标准编制说明
- 《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范（征求意见稿）》团体标准编制说明

- 5、《车规级 AI 芯片电性参数测试方法（征求意见稿）》团体标准征求意见表
- 6、《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范（征求意见稿）》团体标准征求意见

表

